

中信证券股份有限公司
关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 9 月 4 日-9 月 5 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

- （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
- （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；
- （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；
- （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；
- （5）对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 规模增长带来的管理风险

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，与之相匹配的离散型制造模式对公司的管理能力要求较高。公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加，且海内外战略布局存在的跨区域生产等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

(二) 产能储备与市场开发错配的风险

在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，对相关设备的采购需求增多；在行业景气度下降过程中，产业则可能削减资本支出，进而对设备的采购需求有所下降。公司在报告期内储备北京、新加坡产能但存在订单不及预期，短期内导致折旧增加，利润承压的风险。

(三) 公司研发不能紧跟工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险

目前晶圆制造和半导体设备已向 7 纳米及更先进的工艺制程演进，对公司的研发能力不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级产品，提高晶圆制造效率，公司须及时研发相匹配的精密零部件或对原有产品持续优化。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进,不能紧跟客户产品的更新迭代,公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

（四）存货增加导致的风险

报告期内,公司存货账面价值为 99,045.84 万元,占总资产的比例 10.94%,公司存货周转率为 1.34。公司存货水平受产品结构、市场需求关系、供需关系、生产计划与供应链管理、外部环境等因素共同影响。如未来公司不能保持对存货的有效管理,较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力,且可能导致存货跌价准备上升,将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

（五）应收账款风险

报告期内,公司应收账款账面价值为 134,699.87 万元,占总资产的比例为 14.87%,公司应收账款周转率为 1.36。随着零部件国产化的不断推进,国内半导体厂商崛起,回款周期较长的大陆地区客户收入和占比持续提升,如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款周期延长,付款方式发生变化,公司应收账款周转率可能下降,继而可能对公司业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年上半年,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元

主要会计数据	2025 年上半年	2024 年上半年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	172,377.24	150,630.16	14.44
归属于上市公司股东的净利润	1,227.64	12,180.08	-89.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162.43	11,237.71	-101.45
经营活动产生的现金流量净额	14,948.73	-10,028.37	不适用

主要会计数据	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	本期末比上年同期 末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	456,254.27	458,817.42	-0.56
总资产	905,650.82	835,655.97	8.38
主要财务指标	2025 年上半年	2024 年上半年	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.55	-92.73
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.55	-92.73
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	-0.01	0.50	-102.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.27	2.68	减少2.41个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-0.04	2.47	减少2.51个百分点
研发投入占营业收入的 比例 (%)	7.03	6.81	增加0.22个百分点

报告期内，公司营业收入同比增长 14.44%，保持稳健增长态势；其中来自中国大陆以外地区收入表现强劲，增速超 30%，公司在当前复杂多变的国际形势中全球业务的竞争力和市场开拓能力持续提升，为公司未来发展奠定基础。

公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降，主要系公司为积极应对国内外半导体市场变化，把握行业长期发展的机遇，围绕“产能前置、技术前置、人才前置”的中长期战略，主动加大了在关键资源、先进产能及人才方面的前瞻性投入，这些面向未来的战略性举措导致公司利润指标出现阶段性承压。具体原因说明如下：

1、产能前置布局：为应对未来境内外半导体市场的需求，公司提前进行产能布局，相关固定资产陆续投入运营，新增产能的规模效应逐步释放中，因此导致折旧费用同比增加约 5,173 万元，其中计入期间费用的折旧费 1,566 万元，计入生产相关的折旧费 3,607 万元；

2、人才储备先行：为确保公司境内外新增生产基地顺利投产及运营，支撑持续的业务增长与技术创新，公司顺应行业技术要求，提前引入技术、生产、运营等人才，导致本报告期整体人工成本发生额增加约 11,442 万元，其中生产类

人工成本同比增加约 7,754 万元，运营、市场、研发类人工成本同比增加约 3,688 万元，为公司未来的高效运行和技术突破提供了核心保障。

公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比大幅下降，主要系公司归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

同时，报告期内，公司持续对经营性现金流优化管理，客户回款情况较好，实现经营性现金流净额转正的突破。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、大客户战略下的客户资源壁垒，形成稳定增长引擎

在半导体设备精密零部件领域，公司凭借深度服务全球龙头企业的先发优势，构建了稀缺的国内外高端客户资源网络。通过满足半导体行业对零部件极端稳定性的严苛要求，公司已通过多家国内外领先设备制造商的认证体系，凭借行业标杆效应的持续释放，由此建立的商业信誉与供应商记录为持续拓展提供强信用背书，形成"深化大客户合作-提升行业公信力-吸引增量客户"的良性循环。

大客户的技术规范持续驱动研发创新，公司在精密机械制造、表面处理特种工艺及焊接等核心领域铸造深厚技术壁垒，并通过共性技术平台实现工艺整合与智能化生产。在与头部客户的协同中，公司将全球化生产经验转化为定制化服务能力，依托本土化工厂快速响应区域需求，构建从研发到交付的全链路优势（包括柔性制造与可追溯性保障），进一步巩固行业领导地位并铸就长期增长引擎。

2、平台化制造生态驱动半导体精密零部件全链路优势

依托工艺整合与柔性化制造模式，公司可为客户提供全品类精密零部件解决方案，有效降低供应链复杂度并强化合作关系，涵盖机械及机电零组件、气体传输系统等多样化产品，有效降低供应链复杂度并强化合作关系，从而构建起技术整合、敏捷交付与品质保障的全链路平台竞争力。

作为国内少数能服务国际头部客户并具备覆盖全价值链的一站式制造能力

的供应商，公司自 2011 年起基于与国际龙头客户的深度协同需求，启动供应链体系化建设，先后通过 SSQA 质量体系审核及覆盖 36 个模块的 SPACA 认证（涵盖生产制造、内部审计、工程能力、人力资源管理、知识产权保护、采购管理、计划调度及质量管控全流程），通过持续对接国际客户标准，已形成覆盖全价值链的一站式制造能力，构建起行业领先的流程管控优势，能够满足全球半导体设备领域对精密零部件制造的系统化、标准化及可追溯性要求，这一能力支持了从基础金属零部件到复杂气路系统的全链条供应，精准匹配刻蚀、薄膜沉积、离子注入等多样化工艺需求。

3、智能化工艺平台驱动半导体精密零部件智造优势

在半导体设备精密零部件领域，公司通过前瞻性平台化战略突破行业高资本投入与技术碎片化瓶颈，构建覆盖多种特种工艺的完整技术矩阵，形成全品类工艺能力，性能指标全面对标全球半导体设备龙头标准，有效解决行业“单一企业仅深耕个别工艺”的局限，通过全品类供应显著降低客户供应链复杂度。

公司独创“标准化工艺库+智能决策”的柔性制造范式，基于半导体精密零部件共性技术平台，实现复杂首件的模块化拆解与工艺参数自优化闭环控制，结合智能判异系统与一体化在线检测，在多品种、小批量生产场景下达成动态平衡。该模式将传统定制化开发转化为模块化快速响应，使离散制造产能弹性释放，支撑头部客户交付周期，最终形成“工艺广度-制造深度-响应速度”三位一体的智能制造的核心优势。

4、全球化产能矩阵，属地化 IP 保护与供应链韧性构筑公司战略壁垒

公司基于对半导体产业链“区域化重构”的前瞻预判，率先构建以属地化工厂为载体的全球化产能矩阵，通过物理隔离与本地化生产满足国内外客户对技术保密性及 IP 安全的刚性需求，为国内外客户提供符合要求的“可信制造环境”。同时，新加坡的区位优势带来显著政策红利，未来将转化为终端产品价格竞争力。

在运营层面，公司通过“本地工厂-区域客户”的短链模式，有效分散区域政策风险。多极增长模式与平台化技术底座深度融合，使公司能够持续优化资源配置效率，在半导体行业技术密集与资本密集的双重属性下，多极化的产能节点与

平台化能力形成战略协同，持续优化全球供应链响应速度，构筑起难以被竞争对手复制的综合优势。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年上半年	2024 年上半年	变化幅度（%）
费用化研发投入	12,120.13	10,260.82	18.12
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	12,120.13	10,260.82	18.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.03	6.81	增长 0.22 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

公司研发活动正常开展，研发投入总额不存在变化较大的情况。

（二）研发进展

2025 年上半年，公司在研项目的具体进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能涂层工艺开发	20,333.00	2,977.88	14,978.17	持续研发	1、突破热喷涂与原子层沉积复合工艺体系，实现腔体、内衬、匀气盘等半导体设备核心部件的精密涂层制备，完成半导体设备关键部件用高致密、高耐腐蚀、高洁净度氧化钼涂层制备技术研究及主要攻关指标；2、完成产品清洗标准制定；3、开	国内领先	可应用于刻蚀、CVD、ALD、PECVD 等关键制程设备中核心零件

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						发出高反射镀金工艺，制作镀金标准工艺制程规范；		
2	核心功能部件开发	27,701.77	4,036.78	16,530.62	持续研发	1、攻克精孔高粗糙度要求、台阶异形孔精密加工技术、不锈钢金属高耐腐蚀性技术要求；标准化操作、刀具管控等工艺标准开发；设计开发自动化产线；2、建立设计及制造高精度气路阀组件的能力，建立测试能力及平台；3、实现集成电路化学机械抛光设备中保持环零部件产品的国产化开发；	国内领先	可应用于刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光等设备。
3	精密机械制造工艺优化	13,846.90	3,576.42	6,313.16	持续研发	1、打造专线制造模式，提高制造效率，降低制造成本 2、建立复杂多层结构气盘、热盘类焊接制造能力，实现关键核心零部件的国产化替代；3、实现刀具管理数字化建设，先进设备性能与刀具性能的双高效输出，降本增效。	国内领先	生产制造领域
4	气体传输系统工艺技术开发项目	7,142.50	1,529.05	5,560.37	持续研发	通过定制开发专属制造设备和信息化系统实验切割，折弯，清洗，气柜组装，气柜测试的自动化生产，实现重点制造工序的全自动监控，确保信息全流程可追溯性。实现配套管路件、气体传输系统等国产化气体传输零部件制造。	国内领先	应用于 ETCH、CVD、ALD 等关键制程设备中的气体传输管系统

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
合计	-	69,024.17	12,120.13	43,382.32	-	-	-	-

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现公司募集资金使用及披露存在重大问题。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接所持股份均不存在质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

上市公司于 2025 年 6 月 7 日披露《沈阳富创精密设备股份有限公司关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的进展公告》（公告编号：2025-033），2024 年 6 月，公司实际控制人郑广文先生直接持有的公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）831.17 万元出资额被北京市监察委员会冻结（京监冻(2024)130003 号），冻结期限自 2024 年 6 月 6 日起至 2025 年 6 月 6 日止。由于前述事项尚未调查完毕，上述出资额冻结期限将延长自 2025 年 6 月 6 日起至 2025 年 12 月 6 日止。上述事项具体情况详见该公告内容。

经核查，保荐人认为：如郑广文先生所持被冻结的沈阳先进 831.17 万元出资额被执行，郑广文先生仍可控制沈阳先进 50%以上股权进而仍继续控制沈阳先进直接持有的上市公司 16.91%股权，仍为公司控制股权比例第一大股东，不存在公司实际控制人变更的风险。后续保荐人将继续关注上述股权冻结事项的进展情况，督促公司跟进事项进展并及时履行信息披露义务。

上市公司于 2025 年 2 月 15 日披露《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司及相关人员收到辽宁证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-009），因公司自 2023 年 2 月与 A 公司发生交易购买产品，A 公司实为富创精密关联方，上述交易构成关联交易。公司未对相关交易及时审议并披露。中国证券监督管理委员会辽宁监管局对公司及公司董事长郑广文、总经理张璇、时任财务总监杨爽、处罚时点时任财务总监崔静、董事会秘书梁倩倩采取出具警示函的行政监管措施。公司及相关人员收到上述决定书后，高度重视上述问题，并严格按照决定书的要求对存在的问题进行整改，按照关联交易履行披露程序，披露《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-085）。保荐机构将切实履职尽责，积极协助公司整改，并持续关注和跟进其整改进展情况。

除前述情况外，基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

张欢

张 欢

张明慧

张明慧

